

## 深圳市景旺电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

(记录表编号：2025-0102)

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2025年1月2日-1月25日
地点/方式	券商策略会、现场调研
参与单位或 人员（排名 不分先后）	东方证券、东亚前海证券、光大证券、广发证券、国联证券、国泰君安证券、国投证券、国信证券、华福证券、世纪证券、天风证券、招商证券、东北证券、美银证券、中信证券、华创证券、中信建投证券、华泰证券、西南证券、国盛证券、平安证券、中金公司；贝莱德基金、博道基金、长城基金、创金合信基金、大成基金、富国基金、工银瑞信基金、广发基金、国泰基金、国联基金、汇丰晋信基金、交银施罗德基金、摩根基金、南方基金、诺安基金、诺德基金、泉果基金、融通基金、申万菱信基金、万家基金、兴全基金、易方达基金、源峰基金；长江养老、沅谊投资、高腾资产、Grand Alliance、国寿资产、禾其投资、红土创新、华夏未来资本、景林资产、聚鸣投资、Library Group、利幄私募、纽富斯投资、Point72、Millennium Management、太平洋资产、泰康资产、太平资产、星石投资、源乘投资、运舟资本、展博投资、中再资产、资瑞兴投资。
上市公司 接待人员	总裁：刘羽先生 董事会秘书：黄恬先生 证券事务代表：蒋靖怡女士
活动 主要内容	<b>问：公司2025年在手订单情况如何？</b> <b>答：公司目前在手订单情况良好；市场对高频高速、高密度互联、大电</b>

流、高散热等产品的技术要求不断升级和需求不断扩张，其收入增长潜力较大。

**问：公司光模块业务进展？CPO 技术发展是否带来 PCB 规格提升？**

答：公司已批量生产 10G/25G/100G/200G/400G/800G 光模块产品，完成 1.6T 光模块产品的打样并具备量产能力，批量订单导入正在持续进行。CPO 是一种新型的光电子集成技术，旨在将光学元件直接封装在芯片内部，从而实现更高密度的光电集成和更高性能的光通信系统。基于 CPO 技术的产品对所用 PCB 或在插拔稳定性及可靠性、散热、传输损耗等方面将提出更高要求。公司在 CPO 技术领域已有一定技术储备，未来 CPO 相关产品进展主要取决于市场的解决方案及客户的需求。

**问：公司在数据中心领域是否有加大投入的规划？**

答：随着 AI 技术不断演进，端侧应用探索加速，驱动行业对高层数、高频高速、高散热、高密度互联、低损耗等 PCB 产品的需求不断提升，公司将持续加大力度提升技术水平及市场份额，推动订单放量。

**问：公司在 ASIC 产业链是否有布局？**

答：近年来云厂商在 AI 相关基础设施建设领域积极布局，ASIC AI 服务器也成为诸多头部厂商尝试的路线之一。AI 服务器自研芯片的日趋成熟也将带来 PCB 市场的进一步扩容，公司与服务器厂商及 ODM 客户均保持良好的合作关系，努力推进定制化服务器相关产品的预研与打样。

**问：未来公司在高端 PCB 如高多层、HDI 等领域是否有进一步扩展计划？**

答：我们将根据客户的需求持续提升高多层、HDI 的产能。一方面，公司通过对现有工厂的产线和设备进行持续性改造升级，提升生产效率，未来能够进一步释放高端产能；另一方面公司也将结合自身经营业务规划和客户需求，合理配置新增产能。

**问：新投产的信丰工厂新增产能情况？未来的产品定位是？**

答：日前，公司信丰高多层电路板生产项目顺利投产，目前处于产能爬坡阶段，一期工厂产品以大批量 HLC 为主，可用于数通、消费电子、汽车电子、工业控制等领域。

	<p><b>问：公司计划什么时候披露 2024 年年度报告？</b></p> <p>答：公司 2024 年年度报告预计于 2025 年 4 月 29 日披露，敬请关注。</p> <p>注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<b>附件</b>	无
<b>记录时间</b>	2025 年 2 月 5 日整理